

17th Embedded Systems Expo

特别招待贵宾邀请函

尊敬的业界领导，您好！

ESEC 2014-17th Embedded Systems Expo 展会将于 2014 年 5 月 14 日（星期三）～5 月 16 日（星期五）在东京有明国际展览中心盛大开幕。ESEC 展会事务局诚挚邀请活跃在业界第一线的您作为特别招待贵宾前来参加本届展会。

Embedded Systems Expo（ESEC）是日本嵌入式系统开发技术相关级别最大的专业展会，从嵌入式系统开发所需的硬件、软件、组件到系统开发环境都将在此汇聚一堂。本展每年都会吸引很多业界相关企业的系统设计、开发人员、应用技术工程师以及软件的设计、开发人员、应用技术工程师到场，并在会场与参展商直接进行商务洽谈，预订产品。

本展汇聚了行业内最尖端的产品、技术、服务及发展理念，为您引进最新技术，进行各类技术咨询及研究市场发展趋势提供了最好的平台。我们坚信，通过本届展会，您一定会开拓更广阔的商业发展空间。

请您仔细阅读 ESEC 2014 展会概要及本次特别招待活动具体内容等相关资料。

我们非常诚挚地邀请您作为特别招待贵宾亲临本届盛会。

如您接受我们的邀请，敬请填写第 9 页的报名表，并请于 4 月 4 日（星期五）前回复。

*我们将按照报名的先后顺序安排酒店预订，因房间数量有限，
为确保能够为您顺利预定房间，我们建议您尽早报名。

如果您有任何疑问，请随时与展会事务局联系。

事务局全体工作人员诚挚期盼您的莅临参观。

敬颂商祺！

Embedded Systems Expo
事务局长 岛田 周平
事务局次长 森嶋 胜利

17th Embedded Systems Expo 概要

Held inside **Japan IT Week Spring**

17th

EMBEDDED SYSTEMS EXPO

ESEC

- ◆ 日期: 2014年5月14日(星期三) - 5月16日(星期五)
- ◆ 展会时间: 10:00-18:00 (5月16日 10:00-17:00)
- ◆ 会场: 东京有明国际展览中心(Tokyo Big Sight, Japan)
- ◆ 主办单位: Reed Exhibitions Japan Ltd.
- ◆ 展会网址: www.esec.jp/en/



日本最大专业展, **350***家展商云集于此! (*预计)

旨在推动商务洽谈的展会

专业观众

以下厂商的
设计·开发人员

- 电动车·运输设备
- 家电·AV
- 通信设备·手机
- 医疗设备·精密仪器
- 工厂自动化设备
- ...等

洽谈内容

- ◆ 探讨比较各展商的展示 Demo
- ◆ 讨论解决方案
- ◆ 商洽报价单·订购日期

参展商

提供以下产品的企业

- 硬件方案
- 软件方案
- 基板·计算机
- 商用 PC
- 系统开发工具
- Middleware
- 嵌入式系统安全
- ...等

同期展会介绍

IT 专业展会: **Japan IT Week Spring, 1,450*** 家展商参展 (*预计)

关注!

3rd Wireless M2M Expo

为搭建 M2M 系统所需的产品将汇聚于本专业展

■主要参展商: NTT DOCOMO, NTT Communications, HITACHI INDUSTRIAL EQUIPMENT SYSTEMS, Vodafone, Telenor Connexion, Telit Wireless Solutions, Oki Electric Industry 等

关注!

5th Cloud Computing Expo Japan (CLOUD JAPAN Spring)

云计算的相关产品·服务产品将汇聚于本专业展

■主要参展商: Amazon, NTT EAST CORPORATION, NIFTY, NEC, McAfee, salesforce, EMC 等

关注!

11th Information Security Expo (IST Spring)

信息安全对策的相关产品将汇聚于本专业展

■主要参展商: NEC, IBM, KASPERSKY, F5 NETWORKS 等

关注!

4th Smartphone & Mobile Expo (SMARTPHONE JAPAN Spring)

智能手机及移动设备的相关方案、服务产品将汇聚于本专业展

■主要参展商: FileMaker, ZENRIN DataCom, HITACHI SOLUTIONS, NTT IT 等

23rd Software Development Expo (SODEC)

软件开发、维护、运用相关的产品及技术将汇聚于本专业展

■主要参展商: Vietnam Pavilion, Hungarian Pavilion, Philippines pavilion 等

19th Data Warehouse & CRM Expo (D&C)

数据库、企业管理相关的 CRM 方案将汇聚于本专业展

■主要参展商: NOMURA RESEARCH INSTITUTE, JUSTSYSTEMS 等

16th Data Storage Expo (DSE)

庞大信息管理及保护所不可缺少的存储方案将汇聚于本专业展

■主要参展商: Dell, Microsoft, TOKYO ELECTRON DEVICE, MARUBENI INFORMATION SYSTEMS 等

8th Web & Mobile Marketing Expo (Web-Mo Spring)

网络营销、移动营销的相关方案将汇聚于本专业展

■主要参展商: WOWOW COMMUNICATIONS, XyXon, Experian Japan 等

6th Data Center Expo Spring

数据中心搭建及运用的相关方案将汇聚于本专业展

■主要参展商: NTT FACILITIES, Schneider Electric, Fuji Electric, Mitsubishi Electric, Hitachi 等

2nd Direct Commerce Solutions Expo (DIREX Spring)

网络购物、手机购物相关的系统及服务产品将汇聚于本专业展

■主要参展商: JAPAN POST, NEC, Nihon Unisys, YAMATO SYSTEM DEVELOPMENT 等

特别招待活动介绍

招待对象

中国、台湾、韩国的知名企业研究、开发、采购部门经理级别以上的贵宾。

参加条件

- 通过「商务洽谈介绍服务」预约 2 件以上与参展商的商务洽谈。
※详细内容请参考第 8 页“商务洽谈介绍服务”的内容。
- 参加 VIP 贵宾招待宴会。
※免费提供餐饮，在轻松的氛围下可以自由与业界贵宾交流。

招待内容（请选择特典 1 或特典 2）

特典 1

- 提供 2 晚免费五星级酒店住宿招待（5 月 13 日-14 日）
主办单位将安排您入住会场附近的酒店。
 - Hotel Nikko Tokyo（东京日航酒店） <http://www.hnt.co.jp/lang1/>希望延长住宿的贵宾，可以享受展会事务局提供的特别优惠价格。
- 提供酒店至会场的免费专用巴士（5 月 14 日、15 日）
展会事务局将在展会首日和次日，根据展会开幕时间，特别安排酒店到会场的专用巴士。
集合地点和时间等有关详细事项将于会前另行通知。
- 《基调演讲》免费招待（价值 16,000 日元）
演讲内容的详细资料请参考下页。
- 免费使用[海外参观者休息室]
休息室将免费提供无线 Wi-Fi 及各类饮料。

特典 2

- 《基调演讲》免费招待（价值 16,000 日元）
演讲内容的详细资料请参考下页。
- 免费选择参加任意一场技术研讨会（价值 29,000 日元）
演讲内容的详细资料请参考下页。
- 免费使用[海外参观者休息室]
休息室将免费提供无线 Wi-Fi 及各类饮料。

[温馨提示]

- * 每个公司最多可有 5 名人员报名参加“特别招待活动”。
- * 原则上申请后的变更和取消不予受理。
若事先未与事务局联系就擅自取消，需支付酒店全额费用。
- * 请参加人员知悉以下事宜。
 - 会后烦请协助填写问卷调查
 - 发给参展商及展会相关人员的《特别招待贵宾名录》将刊载您的信息（只限公司名、部门及职务，不显示姓名）

17th Embedded Systems Expo 技术研讨会

《基调演讲》 5月14日 [星期三] 13:00 – 14:30

ENGLISH

JAPANESE

◆ **Innovation Driven by Electric/Electronic Development: How Volkswagen is Meeting Present and Future Challenges**



In this keynote speech, Dr. Tanneberger will talk about how Volkswagen is meeting present and future challenges in EE development by using examples of modular systems and various functions used in “The Golf”, which has been honored The World Car of the Year, and “The New Polo”, the benchmark of the small vehicle segment. In addition, the challenges in electrification of e-cars and connectivity will be introduced.

Volkmar Tanneberger, Electric / Electronic Development, Head of Division, Volkswagen AG

◆ **Advanced Safety Technology to Support Mazda’s “Fun to Drive”**



Mazda restructured its safety philosophy with a focus on understanding, trust, and respect for driver/human as “Mazda Proactive Safety”. In the presentation, “i-Activsense”, advanced safety technologies Mazda developed based on the philosophy, per describes, is introduced.

Takahisa Sori, Managing Exective Officer, Research and Development, Mazda Motor Corporation

技术研讨会 附同声英文传译

		ES-2
May 15 [Thu]	9:30	<p>◆ Challenges in the Practical Application of ISO 26262 from the Viewpoint of a Certification Authority</p> <p>With the growing establishment of ISO 26262, this session will survey activities toward its application in Japan and abroad, and introduce associated topics. In particular, directions for further improvement of the safety analysis method and the approach for studying system architecture will be explored.</p> <p style="text-align: right;">Shuhei Yamashita, Technical Director, CTS Functional Safety Group, SGS Japan Inc.</p>
	12:20	<p>◆ Examples of OEM's Activities Supporting the Functional Safety Standard of Road Vehicles (ISO 26262)</p> <p>Two years have passed since ISO 26262, the functional safety standard for automotive electronic control systems, was established, and related companies are in the process of adapting to the standard in their own way. This session will introduce examples of Nissan Motor's activities regarding conformity to the standard, including various topics on the challenges their actual development frontlines are faced with from the standpoint of a car manufacturer.</p> <p style="text-align: right;">Issei Oomura, Senior Engineer, Electric / Electronics Architecture Engineering Group, Electronics Engineering Department, Electronics Engineering Division, Nissan Motor Co., Ltd.</p>

<p>May 15 [Thu]</p>	<p>13:20 16:10</p>	<p>ES-18</p> <p>◆SKYACTIV Technology and Model Based Development Vehicle systems have become complicated and huge to realize advanced functions. To achieve high-level manufacturing in a short period of time, the Model Based Development is indispensable. Focusing on actual development process, I would like to introduce what we aim at and what we achieve with the Model Based Development and what the ideal manufacturing should look like.</p> <p style="text-align: right;">Yasuhiro Harada, General manager, Powertrain System Development Dept., Mazda Motor Corporation</p> <p>◆The current status and the future view of MBD in DENSO The importance of MBD (model-based development) is going to increase further in automotive control to correspond the efforts in advanced safety and the sophisticated control requirements. The presentation will cover the current status and the future view of MBD in DENSO from both sides of the plant modeling and controller modeling.</p> <p style="text-align: right;">Hajime Nomura, General Manager, Electronics Platform R & D Div., DENSO CORPORATION</p>
<p>May 16 [Fri]</p>	<p>9:30 12:20</p>	<p>ES-4</p> <p>◆Fault injection method and approaches to functional safety Introducing future requirements and approaches of Fault injection method for functional safety of automotive electronics.</p> <p style="text-align: right;">Takashi Omizo, Chief Specialist, System & Software Solution Center, Software Platform Technology Group, Toshiba Corporation Semiconductor & Storage Products Company Kazuyoshi Yoshida, Chief Specialist, Mixed Signal IC Div., Automotive IC Marketing & Engineering Dept., Toshiba Corporation Semiconductor & Storage Products Company</p> <p>◆Practice and Prospects of Formal Methods in Software Verification In automotive control systems, it becomes difficult to obtain high reliability at low cost in product developments only with usual testing, because continuous progress of electric and electronic controls makes the systems quite complicated. We make a presentation about our knowledge, subjects and prospects which we have found from our approaches to verification process by formal methods.</p> <p style="text-align: right;">Atsuhiko Ohno, Senior Engineer, Control Software Development Engineering Department, Technology Platform Center, Technology Development Div., Hitachi Automotive Systems, Ltd Masahiro Matsubara, Senior Researcher, Hitachi Research Laboratory, Hitachi, Ltd.</p>

预知技术研讨会更多详情， 敬请登陆：

▶▶▶ www.esec.jp/en/

特典 1 特别招待活动日程

日期	时间	活动内容	集合地点・注意事项
5月13日 (星期二)	15:00 -	酒店入住	Hotel Check-in (酒店信息将另行通知。)
5月14日 (星期三)	9:40 出发	乘坐直达巴士至 展会会场	<ul style="list-style-type: none"> ■ 集合时间: 9:20 ■ 集合地点: 酒店内 ※ 因现场登记人数, 请您务必不要迟到。
	13:00 14:30	E S E C 基调演讲听讲	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接待时间: 12: 30 ■ 会议地点: Tokyo Big Sight 会议栋
	10:00 18:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋
	18:20 20:00	参加贵宾 招待宴会	<ul style="list-style-type: none"> ■ 集合时间: 18:10 ■ 集合地点: 会议栋 1楼 宴会大厅 ※ 免费提供餐饮, 在轻松的氛围下可以自由与业界贵宾交流。
5月15日 (星期四)	9:40 出发	乘坐直达巴士至 展会会场	<ul style="list-style-type: none"> ■ 集合时间: 9:30 ■ 集合地点: 酒店内
	10:00 18:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋
5月16日 (星期五)	10:00 17:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋

特典 2 特别招待活动日程

日期	时间	活动内容	集合地点・注意事项
5月14日 (星期三)	10:00 18:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋
	13:00 14:30	E S E C 基调演讲听讲	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接待时间: 12: 30 ■ 会议地点: Tokyo Big Sight 会议栋
	18:20 20:00	参加贵宾 招待宴会	<ul style="list-style-type: none"> ■ 集合时间: 18:10 ■ 集合地点: 会议栋 1楼 宴会大厅 ※ 免费提供餐饮, 在轻松的氛围下可以自由与业界贵宾交流。
5月15日 (星期四)	10:00 18:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋
5月16日 (星期五)	10:00 17:00	与参展商 商务洽谈	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洽谈地点: Tokyo Big Sight 西展示栋

特别招待贵宾

X

参展商

商务洽谈介绍服务

何谓“商务洽谈介绍服务”？

事先寄送由事务局特别选出的希望与海外企业合作的参展商名单。

若您有意与名单中的企业在展会期间进行商务洽谈，[展会事务局将为您提供与参展商提前预约洽谈时间的服务。](#)

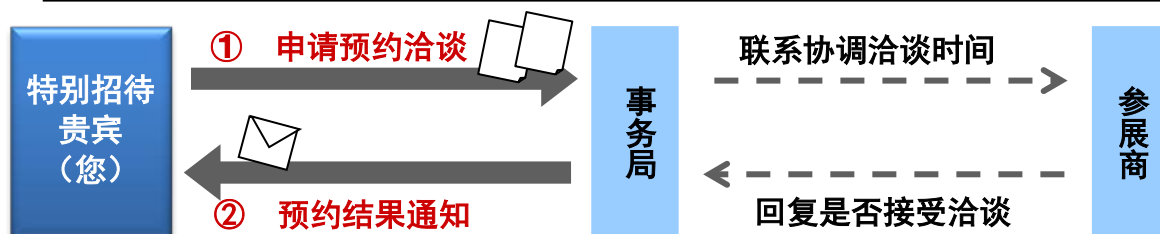


1 本服务的优点

- 事前预约与参展商的洽谈时间，保证展会期间充分有效地参观，提高效率。
 - 参展商会事先针对贵公司进行相关准备，确保展会中能够顺利地进行各种技术咨询*。
- ※技术咨询同时包括：新产品的详细介绍、交货期限、预算、产品规格等各种商谈。

2 本服务的流程

- ① 由事务局寄出参展商的“产品资料”。
请将感兴趣的参展商及希望预约的洽谈时间告知事务局。
- ② 事务局联系参展商预约确定洽谈时间，并通知您。
- ③ 展会期间，事务局的工作人员将指引您前往参展商所在展位。
您可以直接在会场进行技术咨询。



③展会会场进行商务洽谈

<注意事项> 本服务不保证您申请的洽谈预约100%成功，有可能因参展商的时间安排而无法协调，敬请谅解。

ESEC 展会事务局 Reed Exhibitions Japan Ltd.

TEL: +81-3-3349-8518 / FAX: +81-3-3349-8530

ATT:樊丽莉 E-mail: fanl@reedexpo.co.jp